



## RINGKASAN

ELGA SARI. Analisis Faktor Penyebab *Reject* Pada Produk Wafer *Flat* di PT Javaindo Maju Sejahtera, Depok, Jawa Barat. *Analysis of Reject Causes on Wafer Flat Production at PT Javaindo Maju Sejahtera, Depok, Jawa Barat*. Dibimbing oleh DWI YUNI HASTATI.

PT Javaindo Maju Sejahtera merupakan industri yang bergerak dibidang makanan terutama pada produk wafer *flat* dan wafer *stick* dengan berbagai varian rasa. Wafer *flate* memiliki varian sara yaitu wafer *flat cream Cheese* dan wafer *flat cream Chocolate*, sementara pada wafer *stick* memiliki varian rasa yaitu *chocolate*, *strawberry*, *cheese*, dan *chocolate kacang*. Tujuan dilaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di PT Javaindo Maju Sejahtera adalah untuk mengetahui tahapan proses pembuatan wafer serta menganalisis faktor penyebab terjadinya *reject* pada produk akhir dan melakukan tindakan perbaikan sehingga dapat mengurangi terjadinya *reject* pada produk wafer *flat* di PT Javaindo Maju Sejahtera.

Proses pembuatan wafer *flat* dimulai dari proses penerimaan bahan baku, penyimpanan dingin ( $\leq 18^{\circ}\text{C}$ ), penyimpanan kering, pengayakan (40 mesh) pada tepung terigu, penimbaangan bahan baku, bahan tambahan, pencampuran adonan krim, pencampuran adonan kulit wafer, pencampuran adonan krim, penyaringan (40 mesh), pemanggangan (T:125-135 $^{\circ}\text{C}$ ), pengolesan krim, pendinginan (T:5-10 $^{\circ}\text{C}$  t:5-10'), pemotongan *book* wafer, dan pengemasan. Terdapat tiga kategori *reject* untuk dianalisis yaitu wafer terkelupas, wafer patah, dan wafer tidak sesuai standar. Analisis yang dilakukan pada wafer *flat* bertujuan untuk melihat dari ketiga kategori *reject* tersebut mana yang paling banyak mengalami *reject* atau masalah, untuk mencari penyebabnya dan melakukan tindakan perbaikan.

Pada hasil analisis menggunakan *control chart* terdapat 23 titik dari 49 titik, melebihi batas kendali sehingga dapat dikatakan bahwa *reject* dari produk wafer *flat* masih banyak penyimpangan. Pada diagram *pareto*, terdapat satu diagram batang yang paling tinggi yaitu pada kategori wafer terkelupas, yang artinya kategori wafer terkelupas menunjukkan paling banyak masalah 50% dan perlu dilakukan tindakan selanjutnya untuk mengetahui apa sebab dan akibat dari tingginya masalah pada kategori tersebut. Diagram *ishikawa* menunjukan bahwa yang menjadi penyebab tingginya masalah pada kategori wafer terkelupas yaitu faktor manusia, metode, dan mesin. Selanjutnya dilanjutkan dengan tindakan perbaikan, tindakan perbaikan yang dilakukan untuk meminimalisasi terjadinya masalah pada kategori wafer terkelupas yaitu dengan cara menambah tenaga kerja baru dengan pengalaman pekerjaan yang baik dan memberikan pelatihan khusus atau *training* pada para pekerja, memperbaiki sistim mesin atau melakukan penyetingan ulang pada mesin sebelum digunakan dan menerapkan SOP selama proses produksi akhir secara benar.

Kata kunci: *control chart*, *reject*, wafer *flat*